

Press Release



Comment optimiser la surface de connexion de vos circuits imprimés ?

Würth Elektronik vous propose le bonding et élargit ainsi son offre de services :

Plus le circuit imprimé est petit, moins il reste d'espace disponible pour connecter les composants individuels. C'est pourquoi Würth Elektronik a décidé de franchir une nouvelle étape en proposant une solution alternative très fiable : le bonding (micro-câblage).

Le bonding permet d'économiser beaucoup d'espaces mais comporte aussi un autre avantage, selon Philipp Conrad, ingénieur des ventes chez Würth Elektronik, « il apporte une grande fiabilité des techniques de montage et de connexion, de nombreux tests l'ont déjà prouvé ».

Sur demande, Würth Elektronik peut ainsi associer cette technologie à la fabrication d'un circuit imprimé standard. « Ceci est rendu possible grâce à notre étroite collaboration avec la Société B&F Bonding, voisine de nos locaux situés à Schopfheim en Allemagne » explique Philipp Conrad. Cette société est spécialisée dans cette technologie et bénéficie non seulement de nombreuses années d'expérience, notamment en micro-câblage aluminium et or, mais dispose aussi d'une expertise en tech-

<http://www.we-online.com>

Publication free of charge
Sample copy requested

Image file:
WE_cbt_Bonding

26/05/2013
Page 1 of 4

Press Release



niques de câblages spéciales telles que le bonding de puces de précision et l'encapsulation de celles-ci dans une résine.

Et Philip Conrad d'ajouter : « Grâce à notre coopération avec la Société B&F Bonding, nous pouvons désormais répondre aux attentes ciblées de nos clients de façon réactive et avec une grande flexibilité. »

Les avantages du bonding sont multiples :

- Procédé à faible température
- Haut niveau de fiabilité
- Optimisation de la surface
- Grande flexibilité de design
- Possibilités de réparations optimales
- Multiples possibilités de combinaisons matières / composants
- Simplifier la complexité des circuits

Les ingénieurs commerciaux de Würth Elektronik sont disponibles pour répondre aux questions spécifiques de leurs clients et pour leur apporter un conseil d'expert. « Ayant toutes les compétences à disposition via un seul interlocuteur, nous sommes capables de proposer la meilleure solution à nos clients. Nous analysons leurs demandes spécifiques, nous établissons

<http://www.we-online.com>

Publication free of charge
Sample copy requested

Image file:
WE_cbt_Bonding

26/05/2013
Page 2 of 4

Press Release



les différentes options possibles pour la réalisation des circuits imprimés et nous prenons soin enfin de réaliser une production de haute qualité. » promet Philipp Conrad. Par exemple, les puces peuvent être encastrées dans les cavités du circuit imprimé, et si besoin, la dissipation de la chaleur peut être optimisée. Aussi, toutes les sortes de matières proposées par le client sont compatibles avec le micro-câblage.

<http://www.we-online.com>

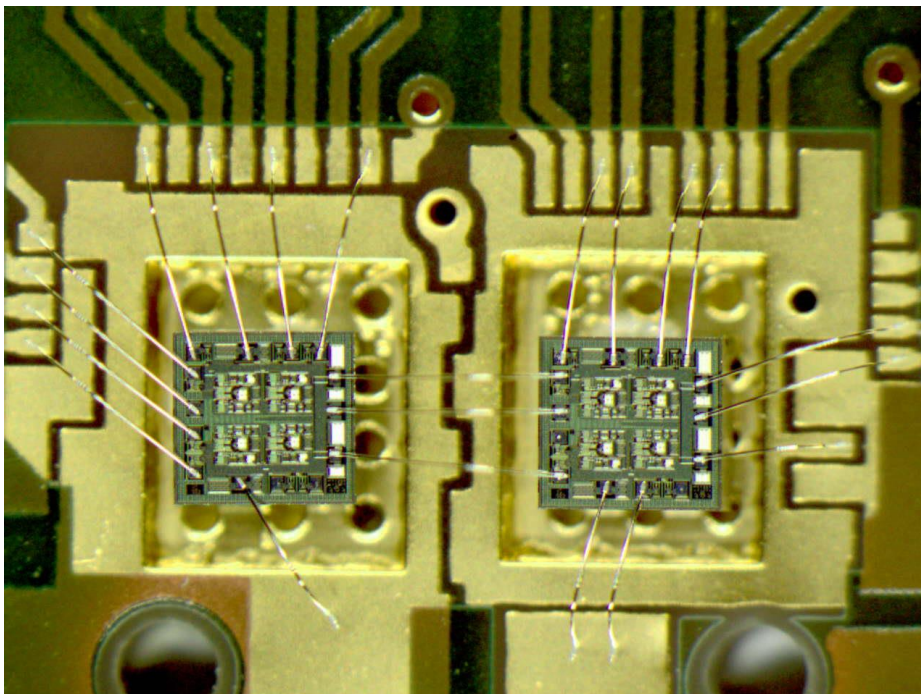
Publication free of charge
Sample copy requested

Image file:
WE_cbt_Bonding

26/05/2013
Page 3 of 4

Image

[Puces dans une « Lasercavity », bonding en aluminium]



Press Release



A propos de Würth Elektronik CBT

(Circuit Board Technology) :

Würth Elektronik CBT est un leader dans la fabrication de circuits imprimés en Europe, dont les sites de production se trouvent en Allemagne, à Niedernhall, Rot am See et Schopfheim. Ce spécialiste des circuits imprimés produit à la fois des solutions standards et des solutions pionnières, très spécifiques et sur mesure selon les applications, maîtrisant toutes les technologies et encourageant le développement de nouvelles techniques comme l'encastrement des composants passifs et actifs dans le circuit imprimé. Sa gamme élargit de circuits imprimés s'étend des circuits imprimés double face et multi couches équipés de technologies standards jusqu'aux circuits très complexes tels que les modèles HDI ou flex rigides comportant une semelle en plaque aluminium par exemple.

<http://www.we-online.com>

Publication free of charge
Sample copy requested

Image file:
WE_cbt_Bonding

26/05/2013
Page 4 of 4